

# 丸文株式会社 2024年3月期 決算説明会

2024年5月16日



東証プライム 7537

1. 2024年3月期 連結決算の概要

2. 2025年3月期 業績予想の概要

3. 株主還元

4. 中期経営計画の取り組み状況

5. 参考資料

# 2024年3月期 連結決算の概要

---

# 2024年3月期 決算サマリ

(百万円)	2023年3月期		2024年3月期			前期比	予想比
	実績	売上比	予想 (10/31)	実績	売上比		
売上高	226,171	—	240,000	<b>236,490</b>	—	+10,319 (+4.6%)	△3,510 (△1.5%)
売上総利益	27,264	12.1%	29,000	<b>29,607</b>	<b>12.3%</b>	+2,343 (+8.6%)	+607 (+2.2%)
販管費	16,267	7.2%	16,500	<b>16,623</b>	<b>7.0%</b>	+356 (+2.2%)	+123 (△0.7%)
営業利益	10,997	4.9%	12,500	<b>12,984</b>	<b>5.5%</b>	+1,987 (+18.1%)	+484 (+3.9%)
経常利益	7,909	3.5%	5,000	<b>5,627</b>	<b>2.4%</b>	△2,282 (△28.8%)	+627 (+12.5%)
親会社株主に 帰属する 当期純利益	5,201	2.3%	3,000	<b>3,401</b>	<b>1.4%</b>	△1,800 (△34.6%)	+401 (+13.4%)

▶ 主にデバイス事業の伸長により売上が増加

▶ 営業利益は、売上の増加要因に加え、円安進行に伴う円換算ベースでの売上総利益の押し上げにより増益

▶ 期初からの円安進行に伴う為替差損（34億円）の計上や、米ドル金利上昇による支払利息の増加（18億円）があったものの、経常利益・当期純利益とも増益を確保

# 2024年3月期 事業別業績サマリ

## ■ デバイス事業

(百万円)	2023年3月期	2024年3月期	前期比
売上高	168,872	<b>179,011</b>	+10,139 (+6.0%)

▶ 民生機器向け半導体が増加

## ■ システム事業

(百万円)	2023年3月期	2024年3月期	前期比
売上高	54,494	<b>54,941</b>	+447 (+0.8%)

▶ 画像診断装置等の医療機器が増加

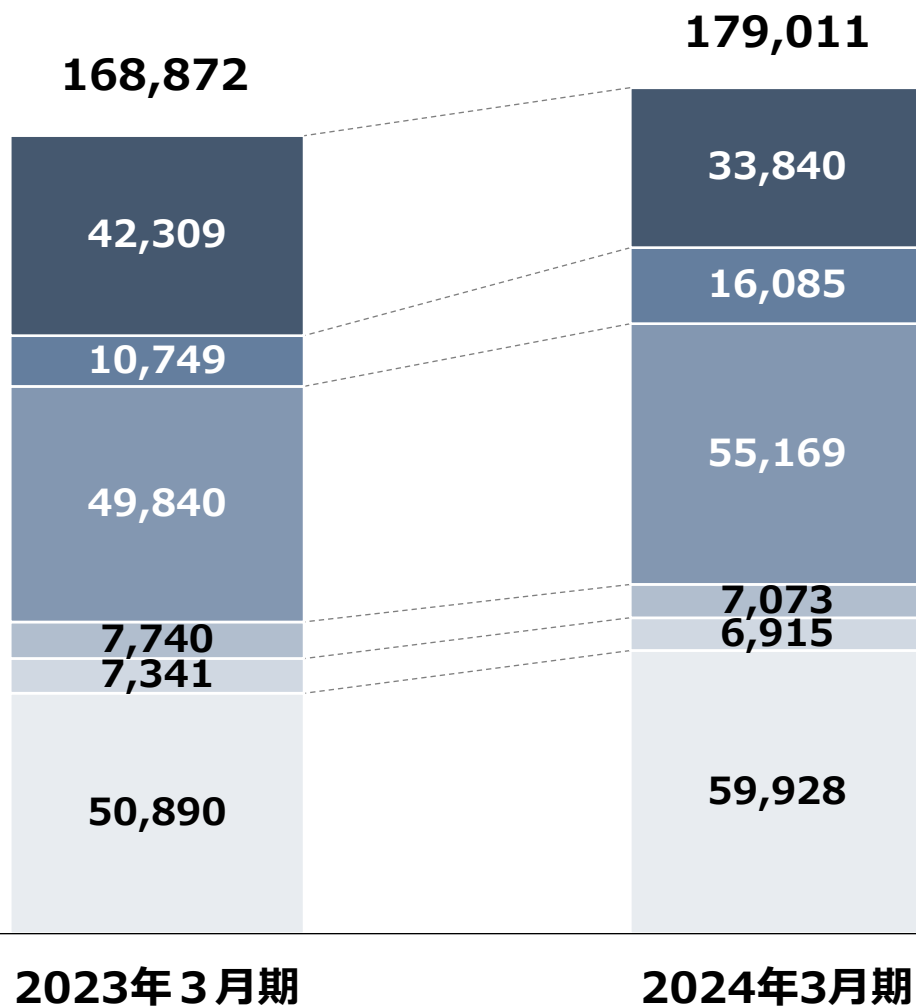
## ■ ソリューション事業

(百万円)	2023年3月期	2024年3月期	前期比
売上高	2,805	<b>2,536</b>	△269 (△9.6%)

▶ 通信インフラ向け部品が減少

# 2024年3月期 『デバイス事業』 品目別売上高

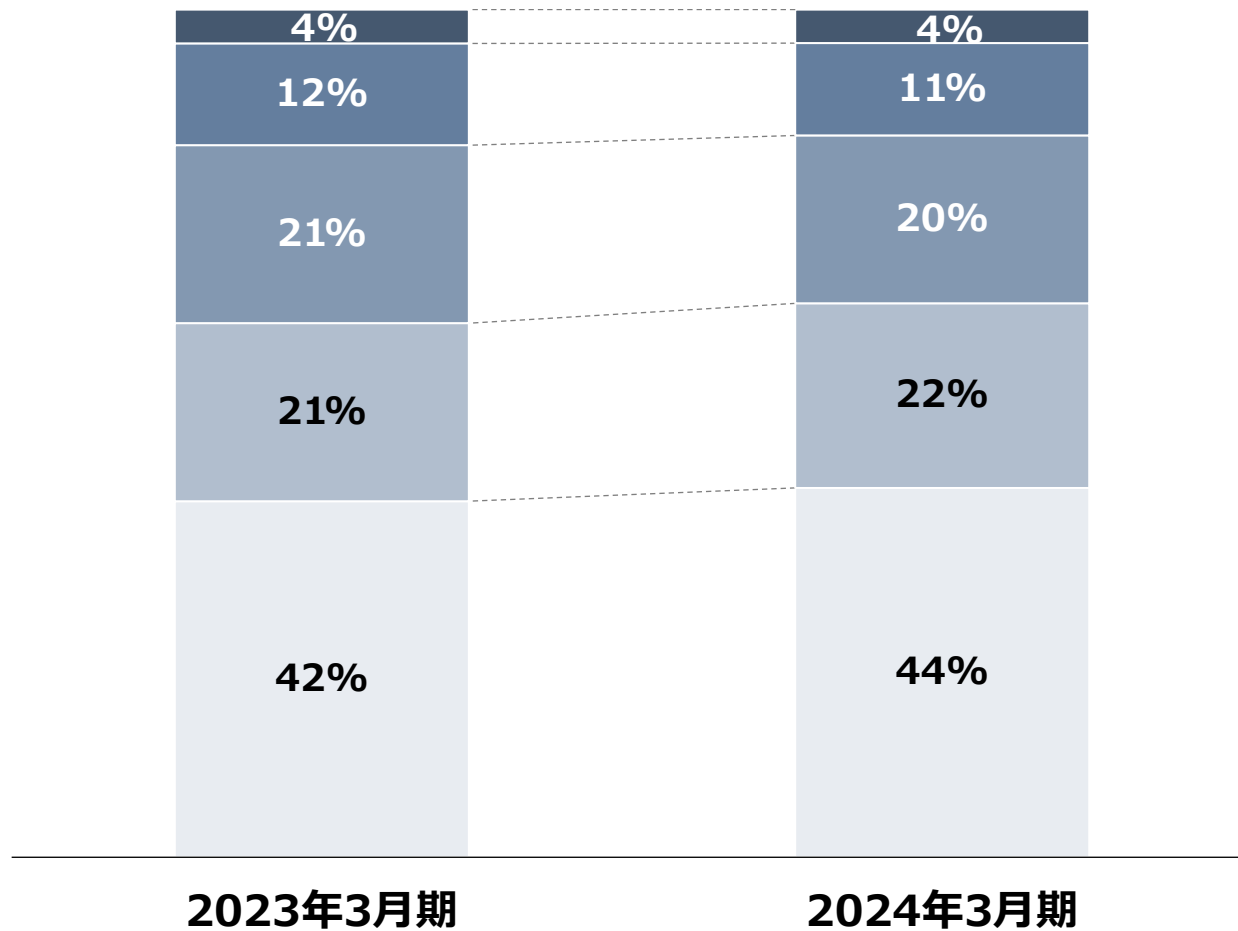
(百万円)



## 主な増減要因

- **電子部品 (△8,469)**  
- 産業機器・通信機器向けの減少
- **カスタムIC (+5,336)**  
- 民生機器向けの増加
- **特定用途IC (+5,329)**  
- 民生機器向けの増加
- **マイクロプロセッサ (△667)**  
- 前期並み
- **メモリーIC (△426)**  
- 前期並み
- **アナログIC (+9,038)**  
- 自動車、PC周辺機器向けの増加

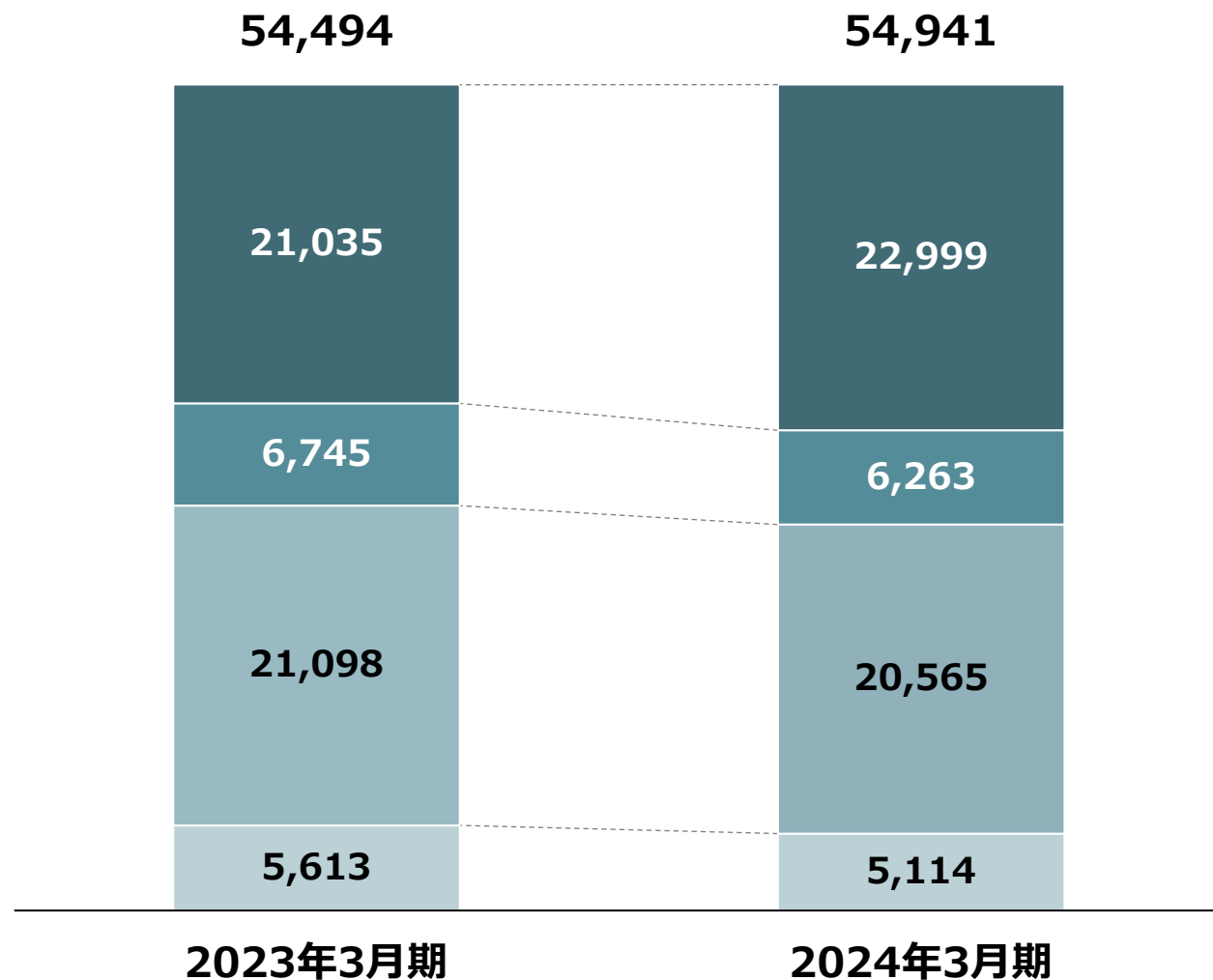
# 2024年3月期 『デバイス事業』 用途別売上構成比



主な増減要因	
■ 通信機器 (±0ポイント)	- 前期並み
■ コンピュータ&OA (△1ポイント)	- 前期並み
■ 産業機器その他 (△1ポイント)	- 前期並み
■ 自動車 (+1ポイント)	- 前期並み
■ 民生機器 (+2ポイント)	- 娯楽製品向けの増加

# 2024年3月期『システム事業』品目別売上高

(百万円)



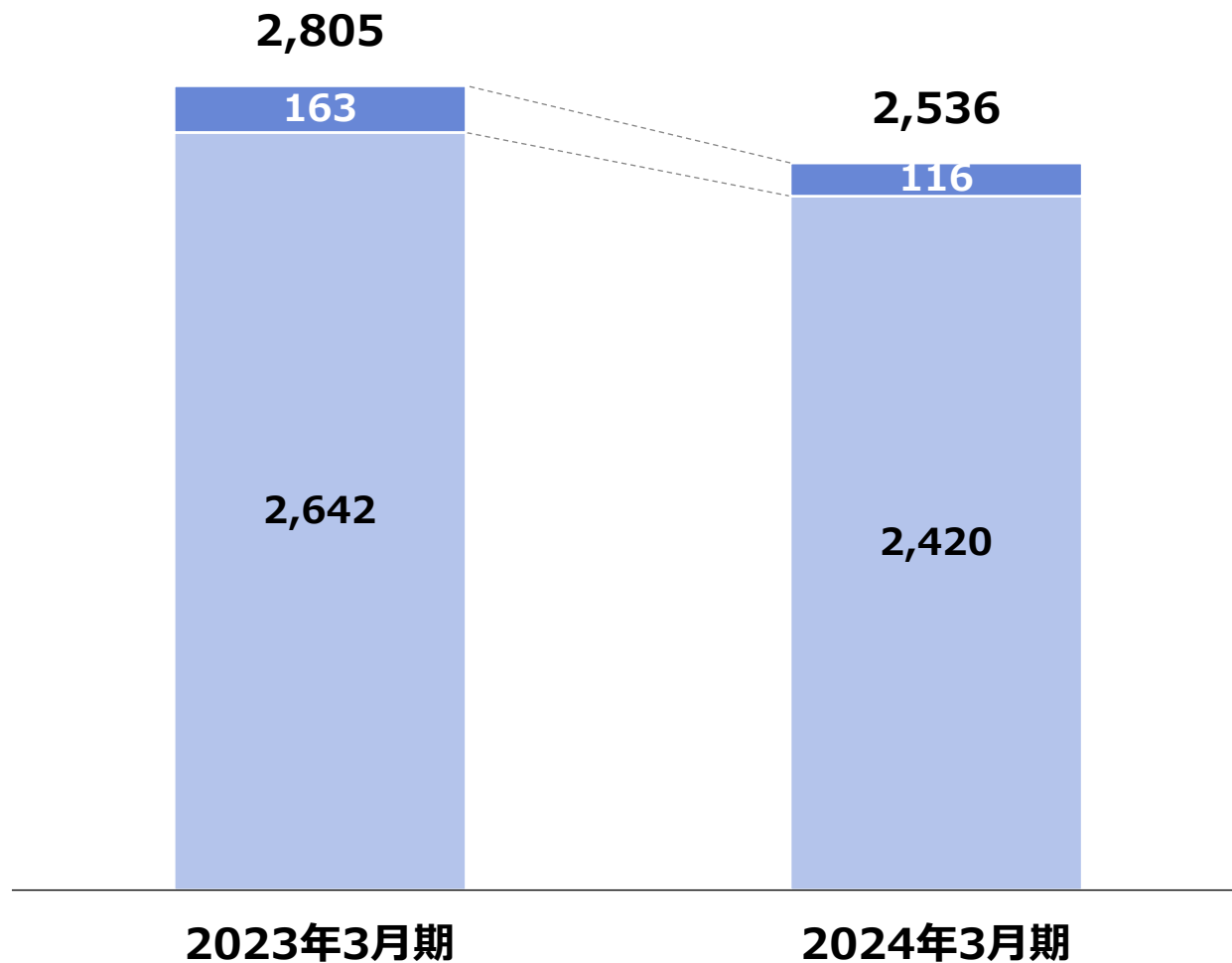
## 主な増減要因

- **医用機器 (+1,964)**  
- 画像診断装置、放射線治療装置の増加
- **レーザー機器 (△482)**  
- 光源部品、レーザー加工装置の減少
- **産業機器 (△533)**  
- 電子部品組立・検査・解析装置の減少
- **航空宇宙機器 (△499)**  
- 電子機材の減少



# 2024年3月期『ソリューション事業』品目別売上高

(百万円)



## 主な増減要因

- AI・ロボティクス (△47)  
- 前期並み
- ICTソリューション (△222)  
- 光通信商材の減少

# 2024年3月期 貸借対照表の概要

(百万円)	2023年3月期末	2024年3月期末	前期末比
<b>資産合計</b>	<b>175,998</b>	<b>174,137</b>	<b>△1,861</b>
流動資産	166,143	162,616	△3,527
現金及び預金	21,253	23,823	+2,570
受取手形及び売掛金	59,415	50,855	△8,560
商品及び製品	54,558	51,316	△3,242
未収入金	28,914	34,847	△5,933
固定資産	9,855	11,504	+1,649
<b>負債合計</b>	<b>122,913</b>	<b>117,676</b>	<b>△5,226</b>
流動負債	117,089	116,675	△413
支払手形及び買掛金	28,005	28,243	+238
短期借入金	69,423	59,507	△9,916
未払金	14,738	19,027	+4,289
固定負債	5,824	1,018	△4,806
<b>純資産合計</b>	<b>53,084</b>	<b>56,433</b>	<b>+3,349</b>

- ▶ 総資産は、前期末から18億円減少
- ▶ 資産の部は、受取手形及び売掛金が85億円、商品が32億円、未収入金が59億円減少
- ▶ 負債の部は短期借入金が99億円減少、未払金が42億円増加
- ▶ 純資産の部は、利益剰余金が11億円、その他の包括利益累計額が17億円増加

# <参考> 為替差損益発生メカニズム

## ▶ I. 当社の為替変動リスクへの対応方針

\*詳細は当社[ウェブサイト](#)よりご確認できます

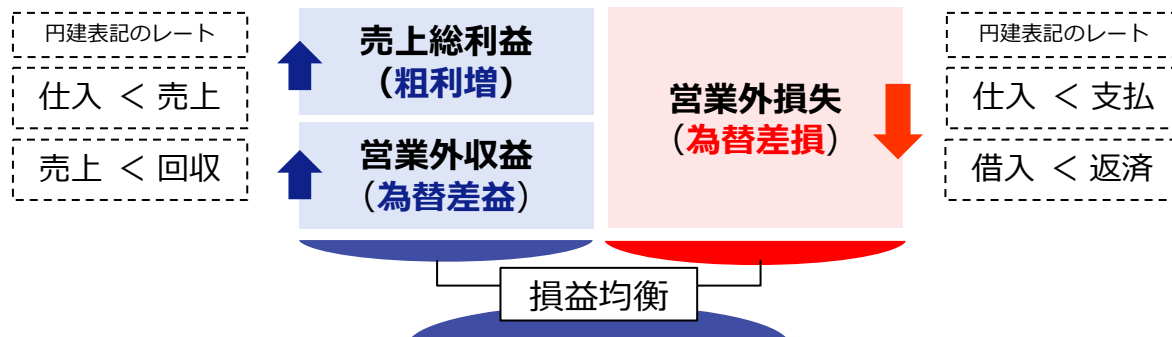
- ・仕入の大半が米ドル建のため、米ドル建売上は円を介さない「ナチュラルヘッジ」、円建売上は「為替予約ヘッジ」を実施

① **米ドル建売上** 仕入～売上・回収の「一連の取引」の条件および対応する資産・負債を米ドル建とし、米ドル建利益を確保

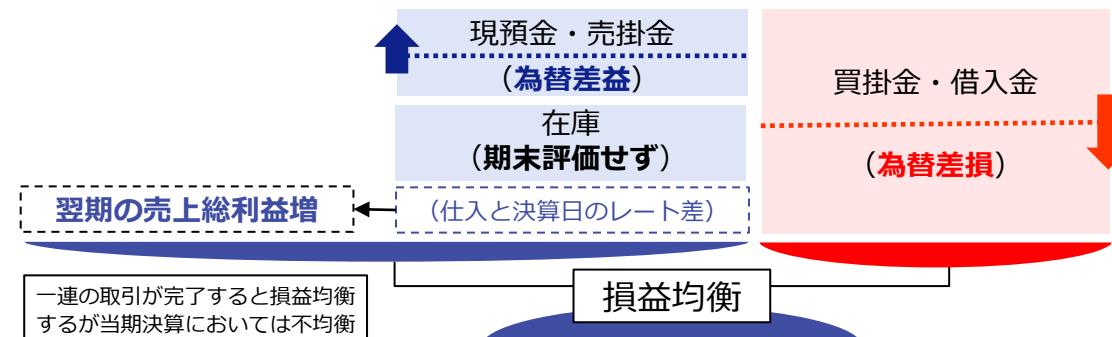
② **円建売上** 仕入債務に対する為替予約を取引明細毎に行い、取引毎の円建の利益を確保

## ▶ II. ナチュラルヘッジ（米ドル仕入～米ドル売上取引）における為替変動の影響

### ① 期間利益への影響イメージ（円安進行時）



### ② 期末評価への影響イメージ（円安進行時）



- ・「一連の取引」のフローを米ドル建で実施し、利益（現預金）を米ドル建で確保していることから、利益確定までのキャッシュフローに為替影響はないが、期間利益と期末時点評価の円建表記に各々影響が発生しうる

#### ① 期間利益への影響

「一連の取引」を円建表記する際のレート差を売上総利益や為替差損益として計上するため、円建表記では「売上総利益の増減」と「為替差損益の増減」の入り繰りが発生しうる（ネット損益は期間内均衡。左上図）

#### ② 期末評価への影響

「一連の取引」で発生する現預金・売掛金・在庫・買掛金・借入金 は米ドル建でのバランスが確保される。各項目は「決算日当日のドル・円レート」で期末評価を行なうが、「在庫」は特に円安進行時において「仕入時のドル・円レート」適用のまま決算時評価替えを行わず、円建表記では資産・負債の均衡が失われ為替差損が発生する。なお、かかる在庫の未認識の評価益が翌期の売上総利益の押し上げ要因となる（右上図）（一方、決算日に向けた円高進行時は損益方向が逆転するが、低価法適用による在庫評価により、かかる在庫評価差が発生しない場合がある。）

# 2025年3月期 業績予想の概要

---

# 2025年3月期 業績予想サマリ

(百万円)	2024年3月期		2025年3月期		前期比
	実績	売上比	業績予想	売上比	
売上高	236,490	—	<b>212,000</b>	—	△24,490 (△10.4%)
売上総利益	29,607	12.5%	<b>25,600</b>	<b>12.1%</b>	△4,007 (△13.5%)
販管費	16,623	7.0%	<b>17,000</b>	<b>8.0%</b>	+377 (+2.3%)
営業利益	12,984	5.5%	<b>8,600</b>	<b>4.1%</b>	△4,384 (△33.8%)
経常利益	5,627	2.4%	<b>5,000</b>	<b>2.4%</b>	△627 (△11.2%)
親会社株主に帰属する 当期純利益	3,401	1.4%	<b>3,000</b>	<b>1.4%</b>	△401 (△11.8%)

\* 2025年3月期通期想定為替レート：142円/ドル

- ▶ 売上高は、デバイス事業で民生機器の反動減や市場全般の在庫調整、競争激化を見込み、減収の予想
- ▶ 営業利益は減収要因に加え、前年度の円安進行に伴う売上総利益の押し上げ効果の剥落により、減益の予想
- ▶ 経常利益および当期純利益においても減収の予想

# 2025年3月期 事業別業績予想サマリ

## ■ デバイス事業

(百万円)	2024年3月期 実績	2025年3月期 予想	前期比
売上高	179,011	150,700	△28,311 (△15.8%)

▶ 民生機器・自動車向け半導体の減少を見込む

## ■ システム事業

(百万円)	2024年3月期 実績	2025年3月期 予想	前期比
売上高	54,941	58,000	+3,059 (+5.6%)

▶ 航空宇宙機器、レーザー機器の増加を見込む

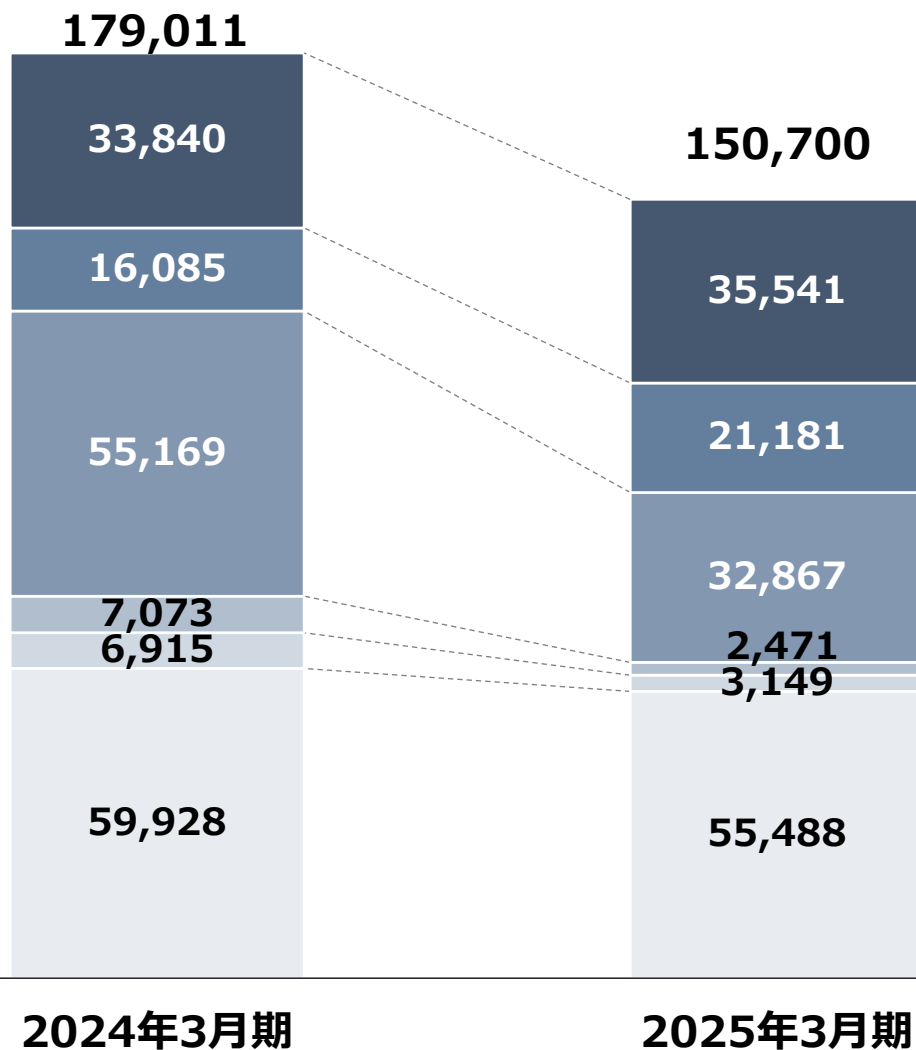
## ■ ソリューション事業

(百万円)	2024年3月期 実績	2025年3月期 予想	前期比
売上高	2,536	3,300	+764 (+30.1%)

▶ AIロボティクスの増加を見込む

# 2025年3月期 『デバイス事業』 品目別売上高予想

(百万円)

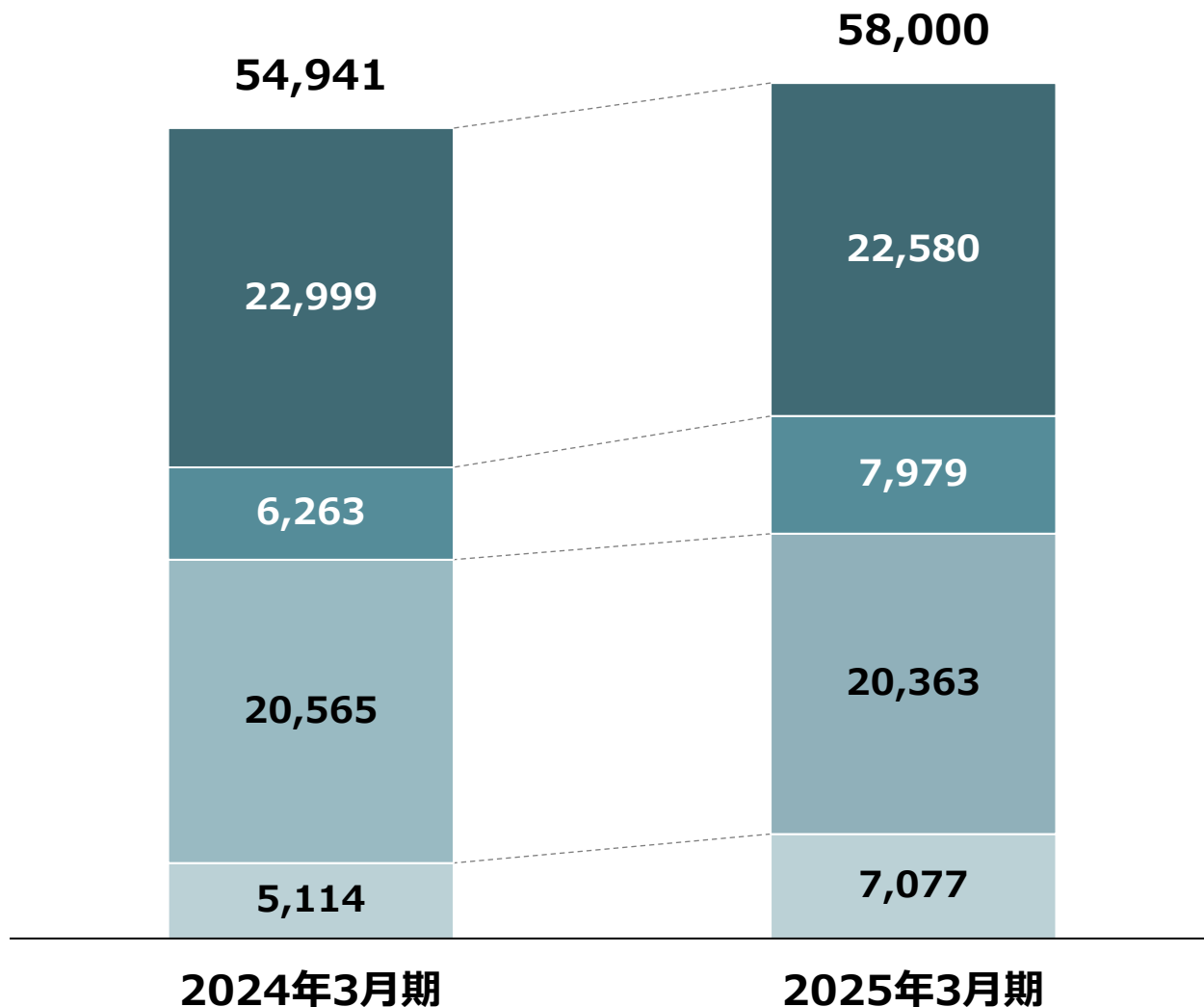


## 主な増減要因

- 電子部品 (+1,701)**  
 - 前期並み
- カスタムIC (+5,096)**  
 - 民生機器向けの増加
- 特定用途IC (△22,302)**  
 - 民生機器向けの減少
- マイクロプロセッサ (△4,602)**  
 - 自動車向けの減少
- メモリーIC (△3,766)**  
 - 自動車向けの減少
- アナログIC (△4,440)**  
 - 民生機器、PC周辺機器向けの減少

# 2025年3月期 『システム事業』 品目別売上高予想

(百万円)



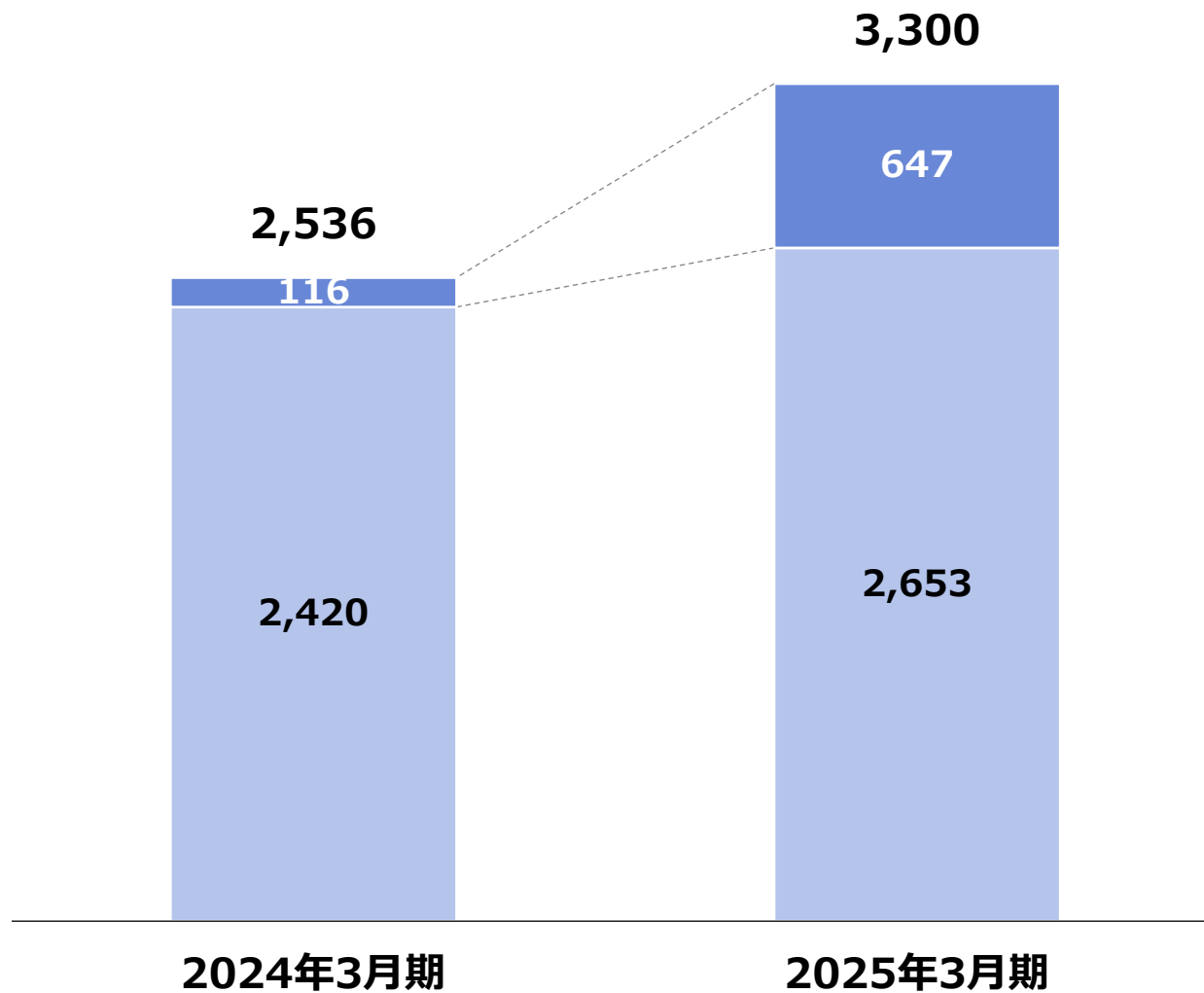
## 主な増減要因

- **医用機器 (△419)**  
 - 前期並み
- **レーザー機器 (+1,716)**  
 - 半導体レーザー、レーザー加工装置の増加
- **産業機器 (△202)**  
 - 前期並み
- **航空宇宙機器 (+1,963)**  
 - 宇宙関連部品の増加



# 2025年3月期 『ソリューション事業』 品目別売上高予想

(百万円)



## 主な増減要因

■ AI・ロボティクス (+531)  
- AI搭載ロボットの増加

■ ICTソリューション (+233)  
- 前期並み

# 株主還元

---

# 株主還元

## 配当方針

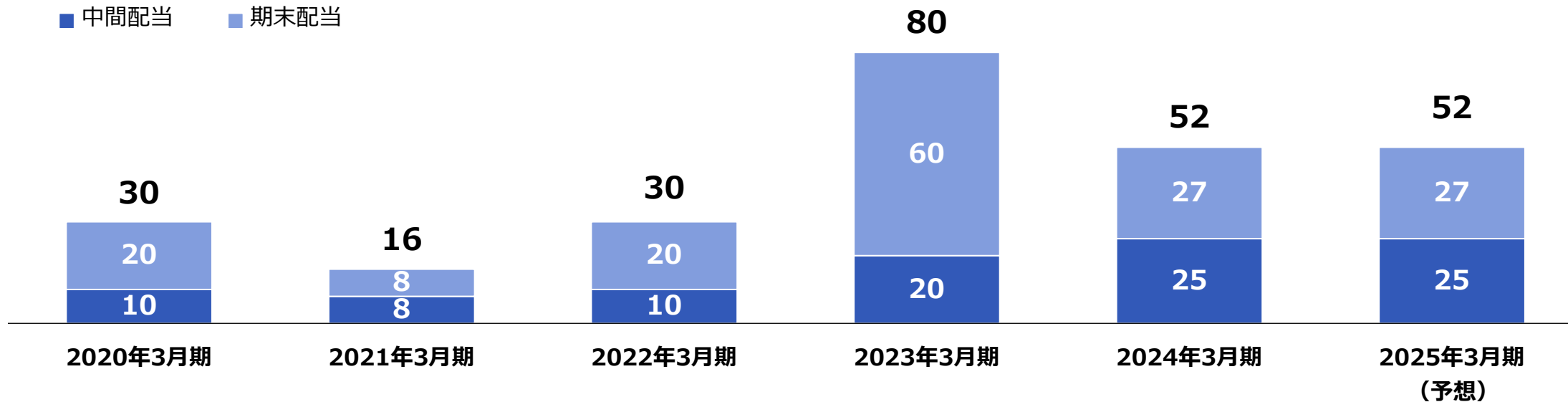
連結配当性向40%またはDOE（株主資本配当率）2.5%のいずれか高い方を目安に、継続的かつ安定的な配当を実施することを基本方針とする

## 2024年3月期の配当

2024年3月期の配当：中間 25円、期末27円の年間52円配当を予定  
配当性向：40.0%、DOE（株主資本配当率）：2.9%

(円)

■ 中間配当 ■ 期末配当



← 前中期経営計画 期間 実績 →

← 丸文Nextage 2024 期間 →

## <参考> 財務施策 「内部留保の活用」

- ▶ 時局に応じた経営優先課題を踏まえつつ、以下4領域において、持続的成長に向けた効率的かつ効果的な資本資源配分に努め、「内部留保の活用」と「持続的成長の実現」の好循環を創出する

### 成長投資機会の追求

#### 非連続成長機会の追求と機動的な投融资案件の取り組みを積極化する

- ・ デジタル化、スマート化、IoT、AI、ロボティクス、次世代通信、医療・ヘルスケア等をテーマに非連続成長機会・戦略的リスクテイク機会を追求し、既存領域での市場拡大や商権拡充、隣接領域でのシナジーの発揮、新たな有望市場の創出を図る
- ・ 事業買収やベンチャー投資は、中計期間（3年間）で自己資本額の5-10%程度を目途とする
- ・ 自社と投資先双方の事業価値創造に寄与する協働／協創を通じた収益リターン実現を目指す

### 業務インフラ投資

#### ITシステム投資を通じた業務の効率化・経営情報の高度化を推進する

- ・ 仕入先、販売先の要望に緻密かつ機動的に対応し、バリューチェーン機能を継続強化する
- ・ 販売管理や管理会計等の経営情報管理を高度化し、収益性や採算性の改善に繋げる

### 人的資本（人財）投資

#### 「人財」育成を企図した人的資本投資を拡充し、競争力を強化する

- ・ 人材マネジメントを高度化し、専門性の高いプロ人材の採用・育成および定着を図る
- ・ ダイバーシティ、働き方、ウェルビーイング施策を展開し、組織文化を変革する

### バランスシート（BS）圧縮

#### BS圧縮・自己資本の適正水準維持を通じて、経営のリスク耐性を高める

- ・ 上記3施策への投資を行いつつ、BS圧縮に取り組み、財務リスクの低減を図る
- ・ 自己資本充実（調達余力確保）を通じ、大規模災害も想定したBCP対応力と事業継続性を担保する
- ・ 自己資本比率は一定水準（20-40%目途）を維持することを目安とする

# 中期経営計画の取り組み状況

---

# 中期経営計画「丸文 Nextage 2024」

▶ 3つの事業成長方針とともに、サステナビリティへの取り組み、事業基盤整備と内部プロセスの改善を推進

## 『丸文Nextage2024』基本方針

### 基本方針

サステナビリティ  
経営の推進

新たな事業領域  
への進出と  
成長基盤の構築

#### 事業成長方針

既存事業の  
「選択と集中」促進  
とソリューション  
開発強化

グループ経営  
の強化

業務基盤整備と  
内部プロセス  
の改善

### 2024年度 財務目標

経常利益 **60** 億円以上 ROE **8%** 以上の確保

# 各事業の成長戦略

## ▶ 各事業セグメントの取り組みを推進しつつ、事業セグメント間のシナジー創出を追求

### デバイス事業

- ▶ 『**基盤強化事業**』として、高付加価値商材開発と商材ミックスの代謝を通じ、グローバルでの業容維持・拡大を図る
- ▶ 生産性と効率性の継続的改善に努め、ローコスト・オペレーションを追求する

2024年度  
売上高目標

**1,430** 億円

### システム事業

- ▶ 『**成長牽引事業**』として、既存ビジネスの持続的成長に加え、新規領域・新規市場での収益基盤拡大を目指す
- ▶ 連結会社間の連携強化を通じたグループシナジーを發揮し、顧客サービスレベルの継続的向上を図る

2024年度  
売上高目標

**630** 億円

### ソリューション事業

- ▶ 『**価値創出事業**』として、成長市場における革新的な商材・技術・サービスの開発、創出を加速する
- ▶ 戦略的事業買収、有望なベンチャー事業投資、外部パートナー提携を通じた非連続成長に貢献する

2024年度  
売上高目標

**40** 億円

# 2023年度の振り返り

- ▶ 売上高は伸長したものの、ドル金利上昇の影響を受け、経常利益は約3割減
- ▶ 利益の減少に伴い、ROEも低下。期末時点のPBRも0.8倍にとどまる

売上高

2,364億円

前期比 +4.6%

経常利益

56億円

前期比  $\Delta$ 28.8%

経常利益率

2.4%

前期比  $\Delta$ 1.1㊦

ROE

6.9%

前期比  $\Delta$ 4.6㊦

PBR

0.8倍

前期比  $\Delta$ 0.05㊦

株価

1,547円

前期比 +13.3%

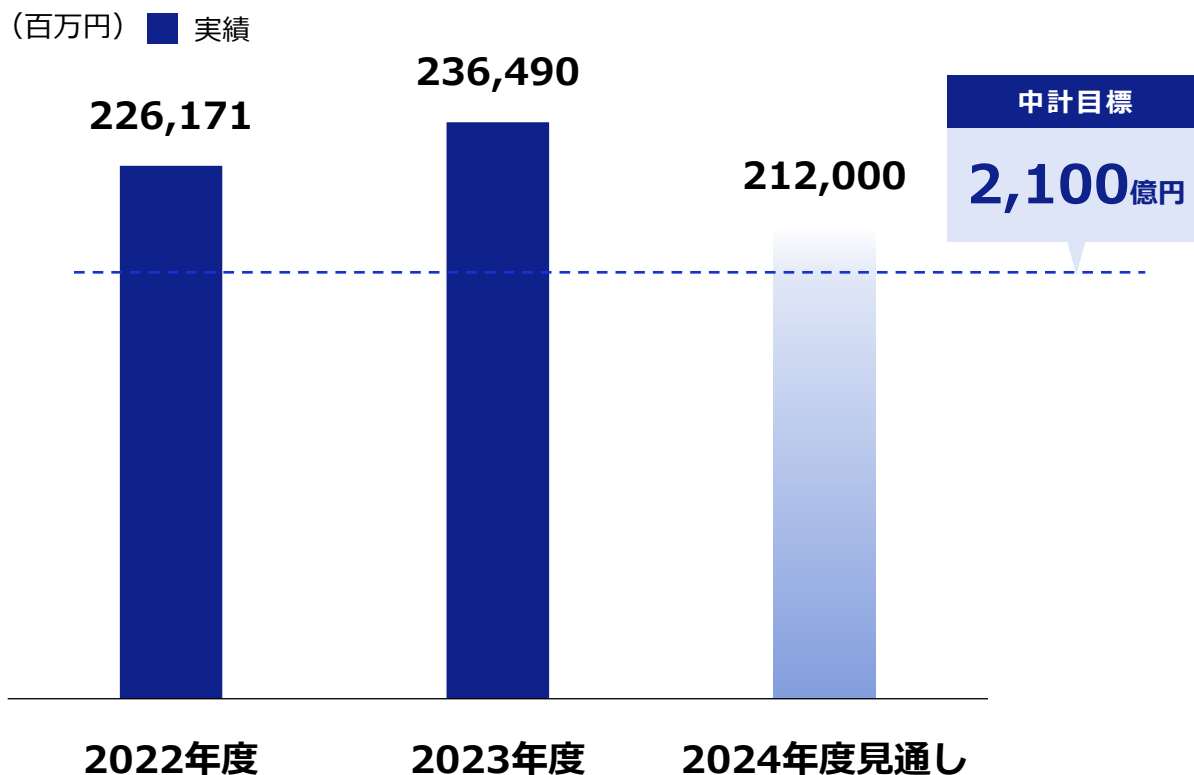
Note : 株価は2023年3月31日の終値と2024年3月29日の終値の比較



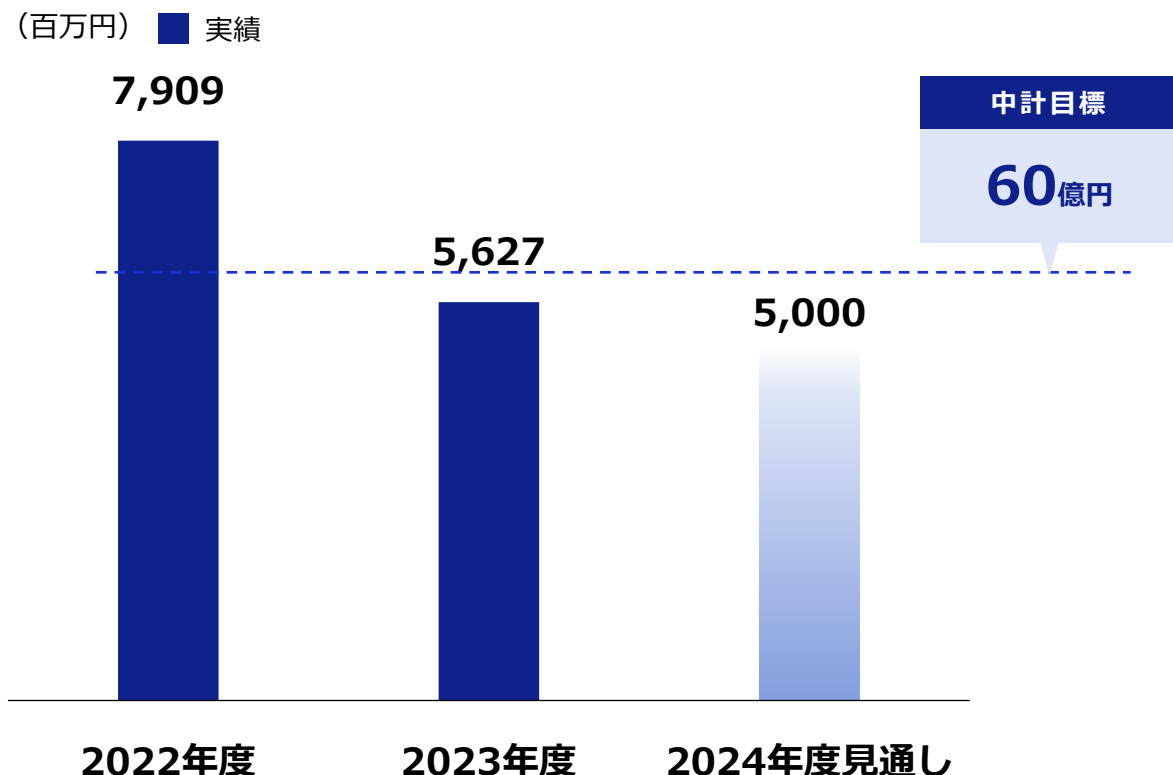
# これまでの進捗状況と2024年度の見通し

- ▶ 売上高は中期経営計画の目標を上回って推移しているものの、ドル金利上昇の影響を大きく受け、経常利益は目標値に対して△10億円となる見通し
- ▶ ドル取引比率が大きく今年度も影響は不可避だが、成長戦略に基づく取り組みを促進し、目標達成を目指す

## 売上高進捗状況



## 経常利益進捗状況



# 『デバイス事業』の総括と取り組み状況

## 2023年度の総括と2024年度の見通し

- ▶ 売上高は2023年度の売上高は前年度を上回る水準で伸長。但し、下期からは在庫調整の局面となった
- ▶ 今年度の売上高は2023年度を下回るものの、中計目標は大幅に上回る見込み

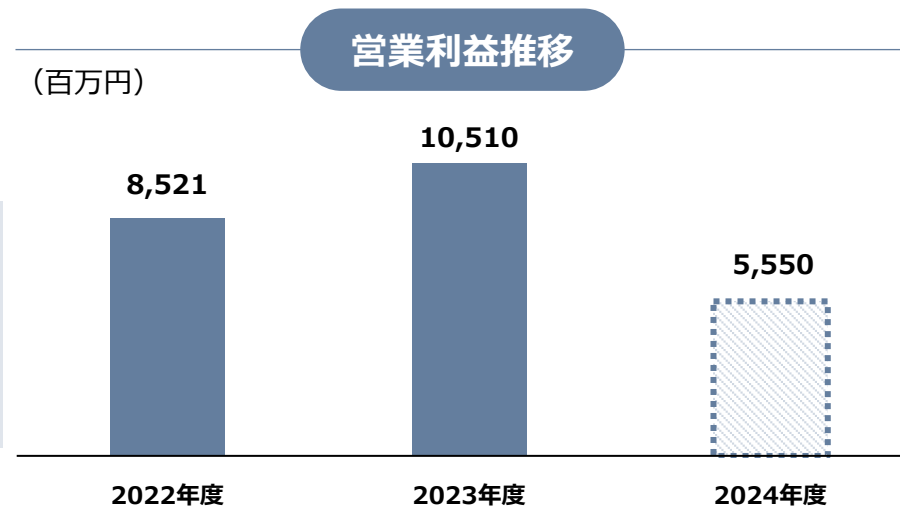
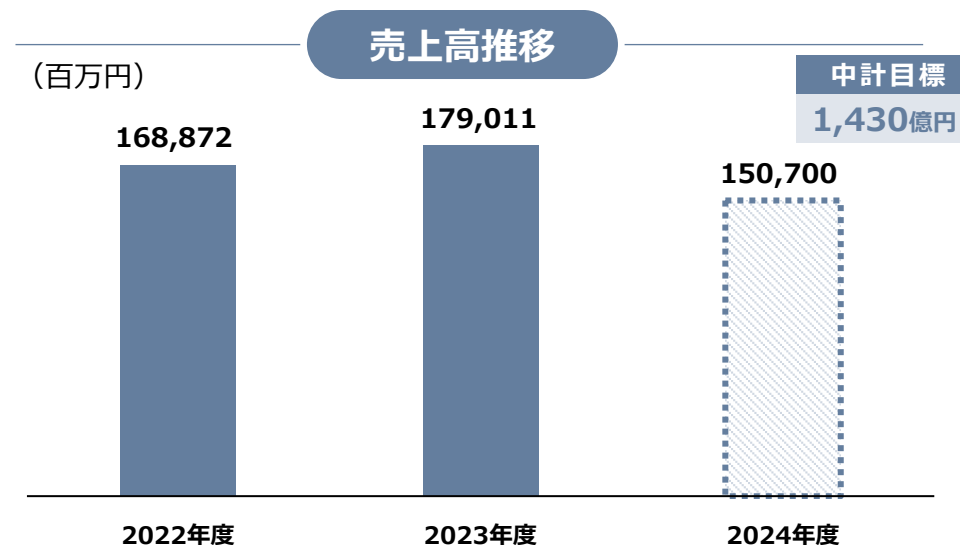
## 取り組み状況

- ▶ 積極的なマーケティング活動により、EV化やグリーン化などの新興需要を開拓
- ▶ パートナー二次店との協業で、より広範な顧客層への拡販を推進
- ▶ 高付加価値のFPGA\*やコネクタをはじめとする電子部品を拡販

\*Field Programmable Gate Arrayの略で、プログラム書き換えが可能なIC

## 課題と対応策

- ▶ 新規商材、新規商権の開拓を進めつつ、新たな需要の取り込みを促進する
- ▶ 在庫圧縮などにより資本/資金の効率化に取り組むとともに、さらなるローコスト・オペレーションを追求する



# 『システム事業』の総括と取り組み状況

## 2023年度の総括と2024年度の見通し

- ▶ 2023年度の売上高は前年度並みで着地。設備投資の抑制や案件の後ろ倒しにより、期初予算を下回る結果となった
- ▶ 2024年度は航空宇宙機器やレーザー機器で需要を取り込み、売上・利益ともに伸長する見通しだが、産業機器の需要減により中計目標は未達の見通し

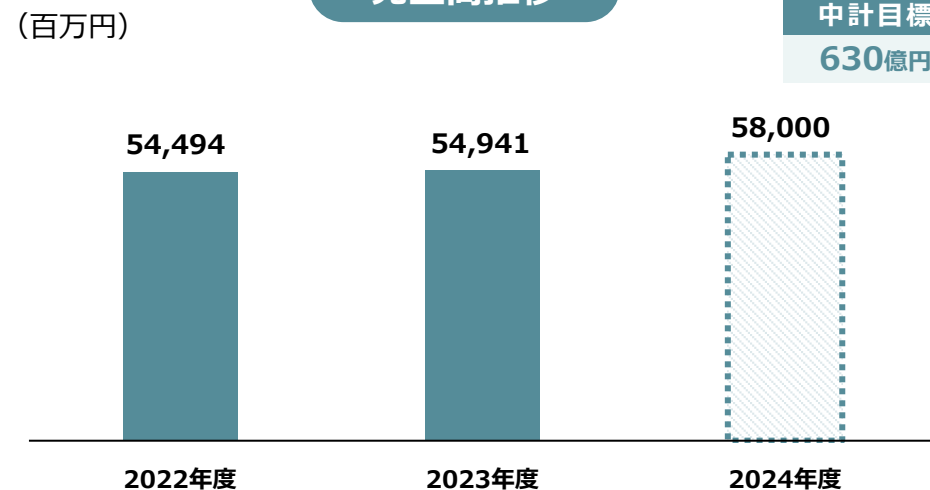
## 取り組み状況

- ▶ 物理計測の分野で最先端技術を有する製品の取り扱いを促進
- ▶ 半導体・電子部品メーカーや流通市場へのDX化提案、実証試験を推進
- ▶ 東南アジアや中米地域に進出している日系メーカーへの産業機器の販売網を構築
- ▶ 複合材加工や三次元造形など、レーザー接合加工技術の提案を強化

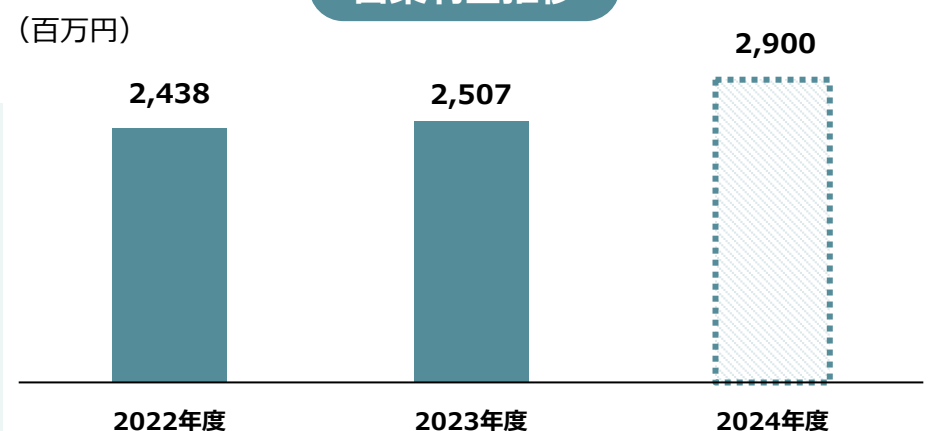
## 課題と対応策

- ▶ 既存領域における競争優位性の一層の強化
  - ・ ハイエンド商材の取り扱いを拡充する
  - ・ インダストリアルDXのソリューション開発を促進する
- ▶ 新規領域拡大への取り組み促進
  - ・ 海外市場での販売強化に取り組む

### 売上高推移



### 営業利益推移



# 『ソリューション事業』の総括と取り組み状況

## 2023年度の総括と2024年度の見通し

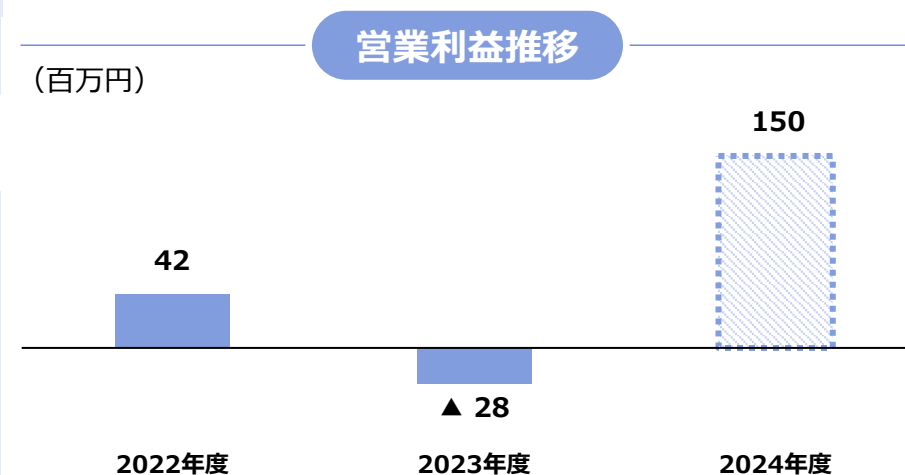
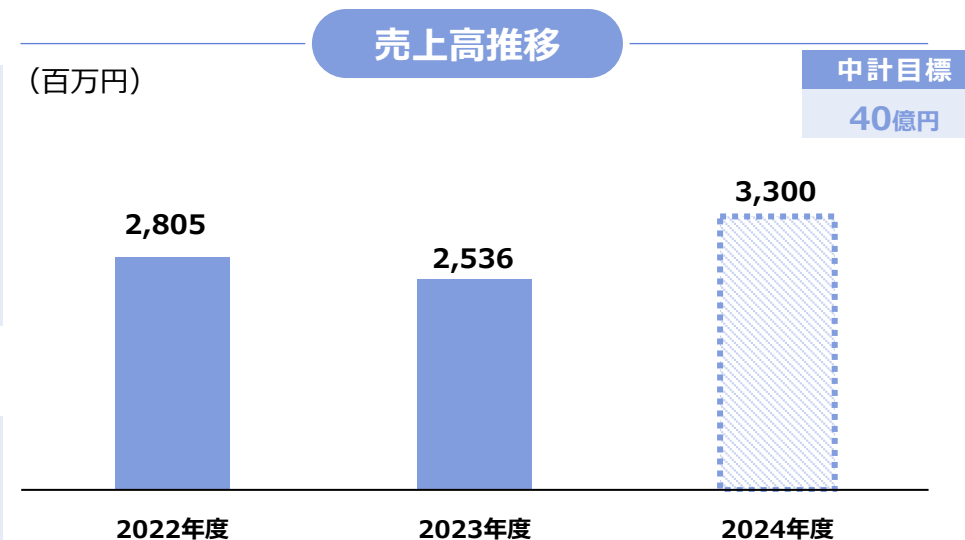
- ▶ 2023年度はAI・ロボティクスの立ち上げ遅れに加え、ICTソリューションも減少
- ▶ 2024年度はAI・ロボティクス、ICTソリューションともに伸長を見込むが、新規ビジネスの計画後倒しにより、中計目標は未達の見通し

## 取り組み状況

- ▶ ICTソリューションのクラウドサービスを拡充
  - ・ 「イーリス顧客ポータル」を通じて提供するサービスの開発を促進
- ▶ NUWA Robotics社と資本提携し、介護・医療市場向けにAI コミュニケーションロボットの販売を開始

## 課題と対応策

- ▶ 新たなビジネスモデルの確立、早期の事業化
  - ・ 市場ニーズに迅速に対応し、事業の早期立ち上げ、収益化に取り組む
- ▶ 専門性の高い人材の確保、育成
  - ・ デジタル人材を確保・育成し、新たなビジネス機会を獲得する



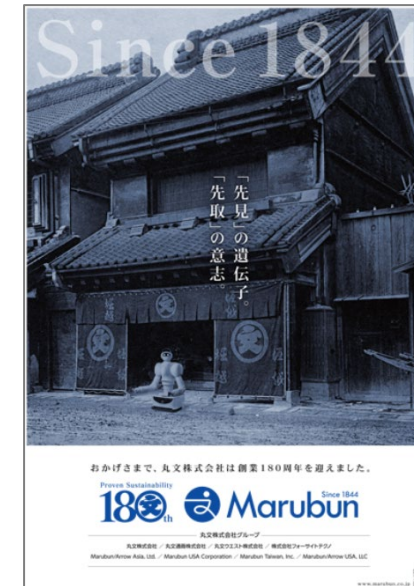
# サステナビリティ経営の推進・業務基盤の整備と内部プロセス改善

## サステナビリティ経営の推進

- ▶ **マテリアリティ（重要課題）を特定** \*次頁参照
  - 次期の中期経営計画で取り組み・KPIを具体化する
- ▶ **IR・SR・PR活動を一層強化**
  - 能動的なアプローチにより機関投資家との面談を実施
  - 丸文ブランド強化の一環として創業180周年記念広告を展開
  - 統合報告書の制作を推進
- ▶ **人的資本経営に対する取り組み強化**
  - 人的資本戦略委員会を新設。パーパス・経営戦略に連動した人的資本戦略を構築・推進する
  - 多様なコンテンツを揃えたe-learningシステムを導入

## 業務基盤の整備と内部プロセス改善

- ▶ **次世代の統合基幹システムの構築を推進**
  - 新規ビジネスへの柔軟かつ迅速な対応と、業務生産性の大幅な改善を実現する
  - 新技術を活用し、ITレジリエンスを強化する



▲丸文180周年記念広告ポスター2種

Proven Sustainability

180<sup>th</sup>

▲記念ロゴ

# マテリアリティの特定

## 丸文グループのマテリアリティとキーテーマ

	マテリアリティ	キーテーマ*
 環境	地球環境の持続可能性の回復と保全への寄与	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 循環型社会への取り組みを推進する</li><li>■ クリーンテクノロジーを発掘し提供する</li></ul>
 社会	安全で豊かなサステナブル社会の実現	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 社会や地域への貢献活動を拡大する</li><li>■ 信頼できる製品・サービスと、安定的なサプライチェーン基盤を提供する</li></ul>
 人的資本	パーパスと融合する人的資本戦略の高度化	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 高度な専門家集団を形成する人材採用・育成プログラムを強化する</li><li>■ 社員エンゲージメントを高める</li><li>■ 女性社員の登用と活躍を推進する</li></ul>
 ガバナンス	盤石なグループガバナンスの構築と運営	<ul style="list-style-type: none"><li>■ ステークホルダー・エンゲージメントを向上する</li><li>■ グループ全体にわたるコンプライアンスの強化と浸透を図る</li><li>■ 戦略管理とリスク管理を継続的に高度化する</li></ul>
 自社	最先端技術とソリューション開発を通じた社会課題の解決	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 社会要請の変化を先取りし、新たな付加価値を有する製品・サービスを導入する</li><li>■ エレクトロニクス商社としてのソリューション提供を通じて、お客様の課題を解決する</li><li>■ 戦略的な提携・協業を通じ、イノベーションを創出する</li></ul>

\*当社「マテリアリティ」の各項目に関する当社取組の方向観を指す \*\*更なる詳細は当社[ウェブサイト](#)よりご確認頂けます

Proven Sustainability

180<sup>th</sup>

 **Marubun** Since 1844

# 参考資料

---



# 企業概況

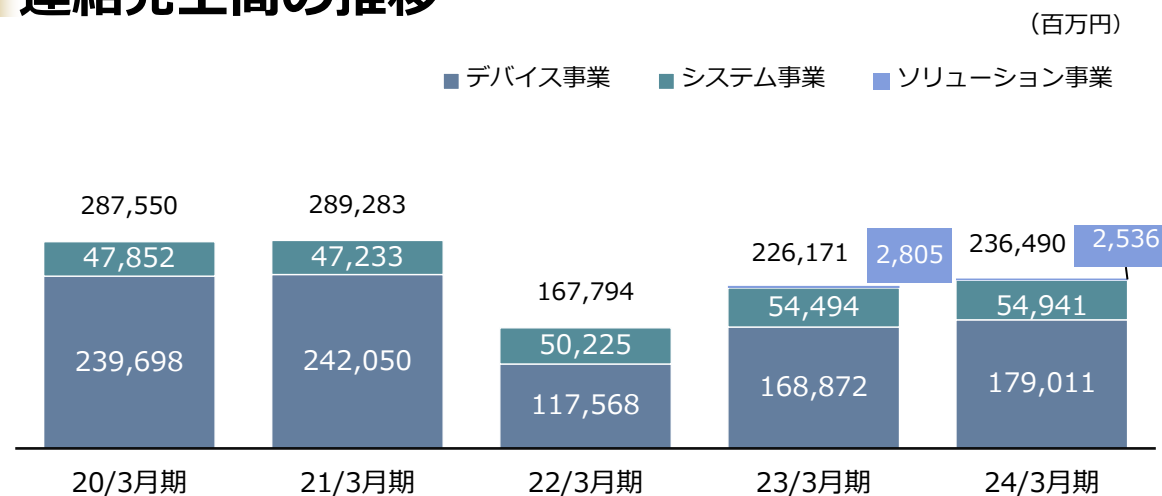
## 会社概要

創 業	1844年（弘化元年）
設 立	1947年（昭和22年）7月
所 在 地	東京都中央区日本橋大伝馬町8番1号
資 本 金	62億1,450万円
決算期日	3月31日
代 表 者	代表取締役社長 飯野亨
売 上 高	連結 236,490百万円（2024年3月期） 単体 180,265百万円（2024年3月期）
従業員数	連結 1,167名（2024年3月末） 単体 615名（2024年3月末）
株式上場	東京証券取引所 プライム市場 （コード:7537）

## 事業領域

デバイス事業	システム事業	ソリューション事業
<ul style="list-style-type: none"><li>半導体</li><li>電子部品</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>航空宇宙機器</li><li>産業機器</li><li>レーザー機器</li><li>医用機器</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ICTソリューション</li><li>AI・ロボティクス</li></ul>

## 連結売上高の推移



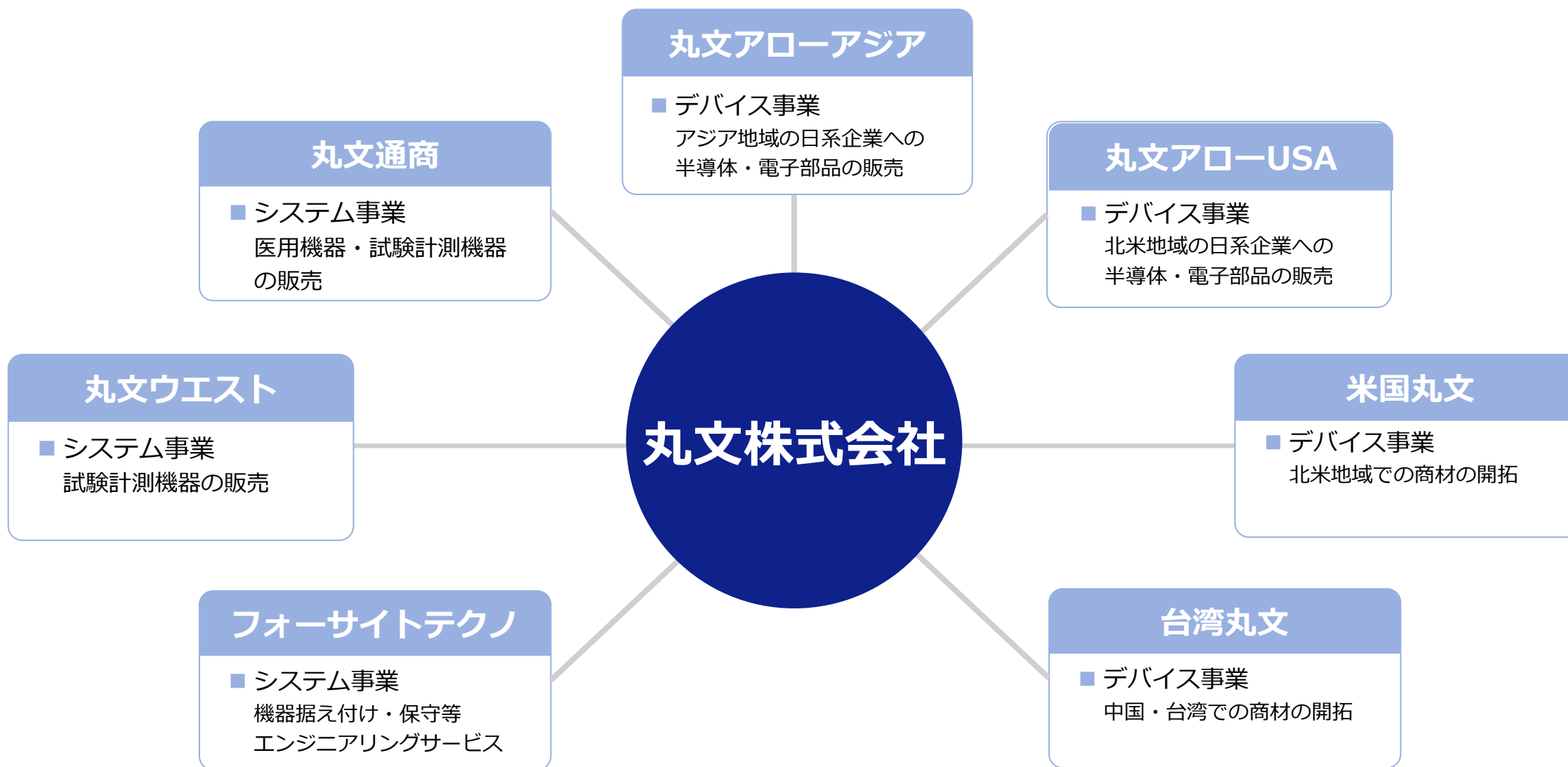
# 沿革

## 国内

- 2022 東京証券取引所プライム市場に移行
- 2008 エレクトロニクス商社で初めて特定輸出者として認証
- 2007 フォーサイトテクノを子会社化
- 2005 丸文ウエストを設立
- 2001 東京証券取引所市場第一部上場
- 1997 東京証券取引所市場第二部上場
- 1965 集積回路を国内で初めて輸入販売
- 1961 金沢支店を分社し、丸文通商を設立
- 1952 Rocke International社と代理店契約し、独自の米国製機器の輸入販売を開始
- 1947 機械器具、日用雑貨類の販売と輸出入を目的に丸文株式会社を設立
- 1897 呉服問屋を停止し、資産管理を目的に堀越事務所を設立
- 1844 現本社所在地で呉服問屋「堀越」（屋号「丸文」）を創業

## 海外

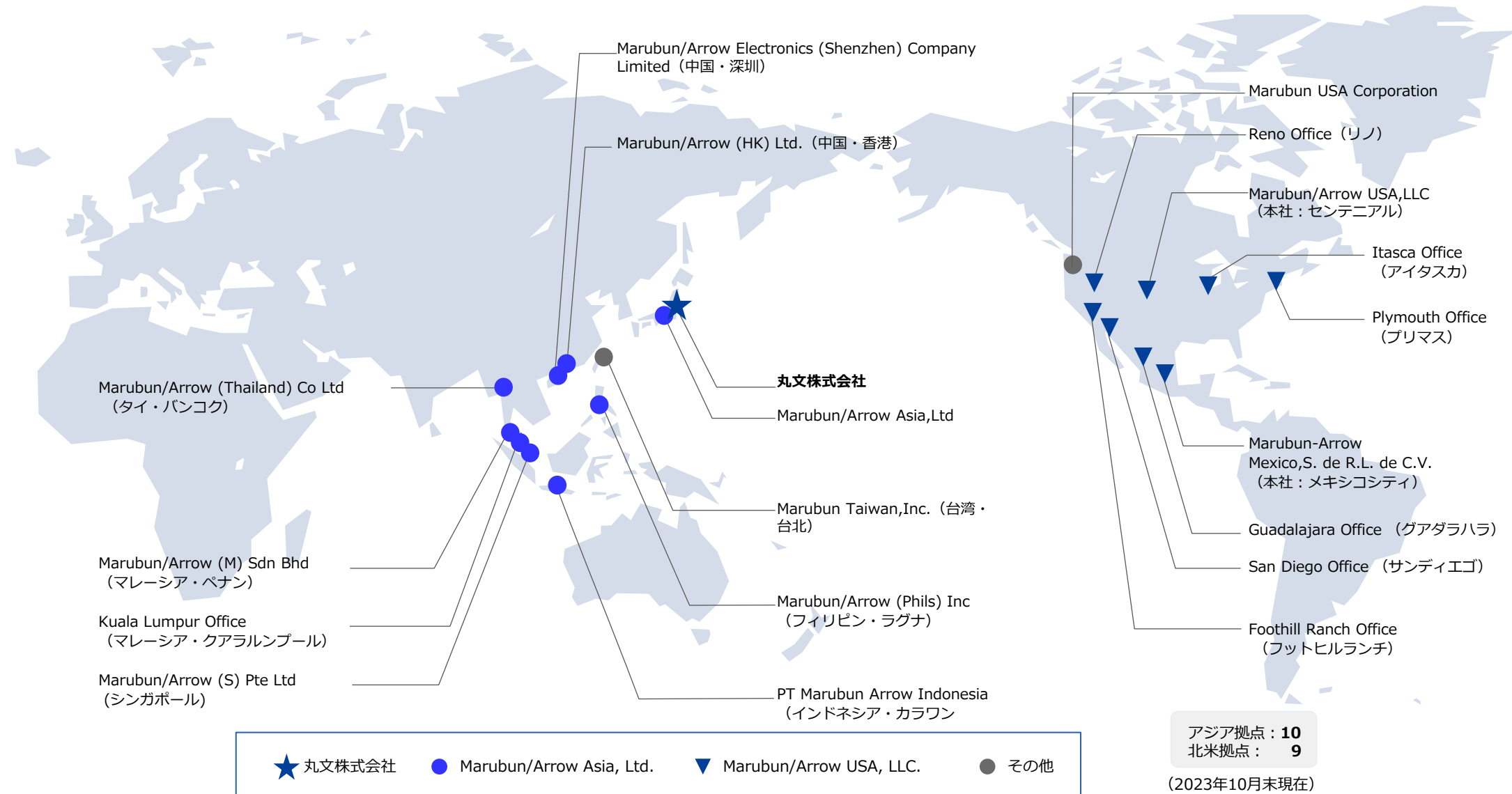
- 2014 インドネシア、メキシコに現地法人を設立
- 2013 深圳に現地法人を設立
- 2006 マレーシアに現地法人を設立
- 2002 フィリピン、上海に現地法人を設立
- 2001 タイに現地法人を設立
- 1999 米国Arrow Electronics社と折半出資でMarubun/Arrow USA,LLCを設立
- 1998 米国Arrow Electronics社と折半出資でMarubun/Arrow Asia,Ltd.を設立
- 1994 香港に現地法人を設立
- 1989 台湾に現地法人を設立
- 1988 シンガポールに現地法人を設立
- 1968 米国駐在事務所を設置

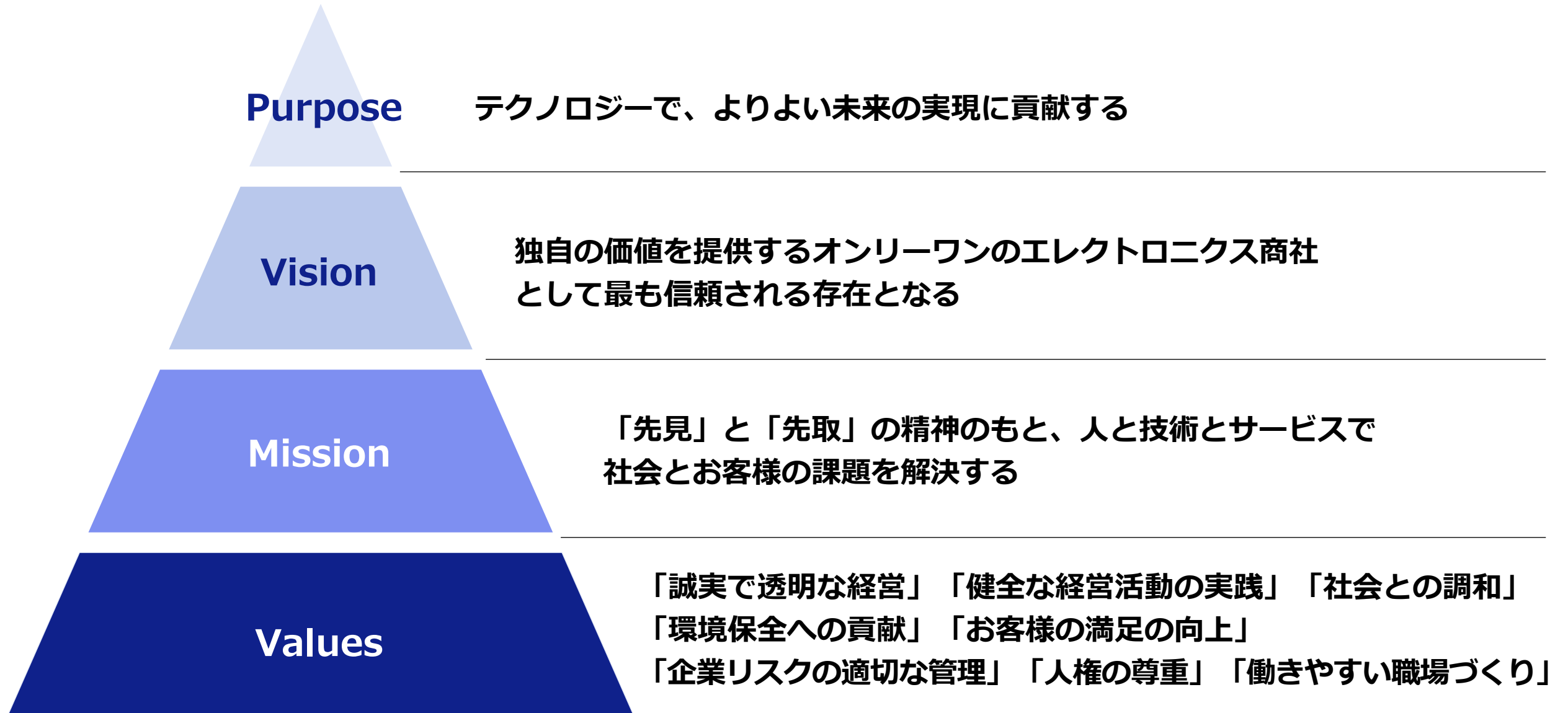


# 国内拠点



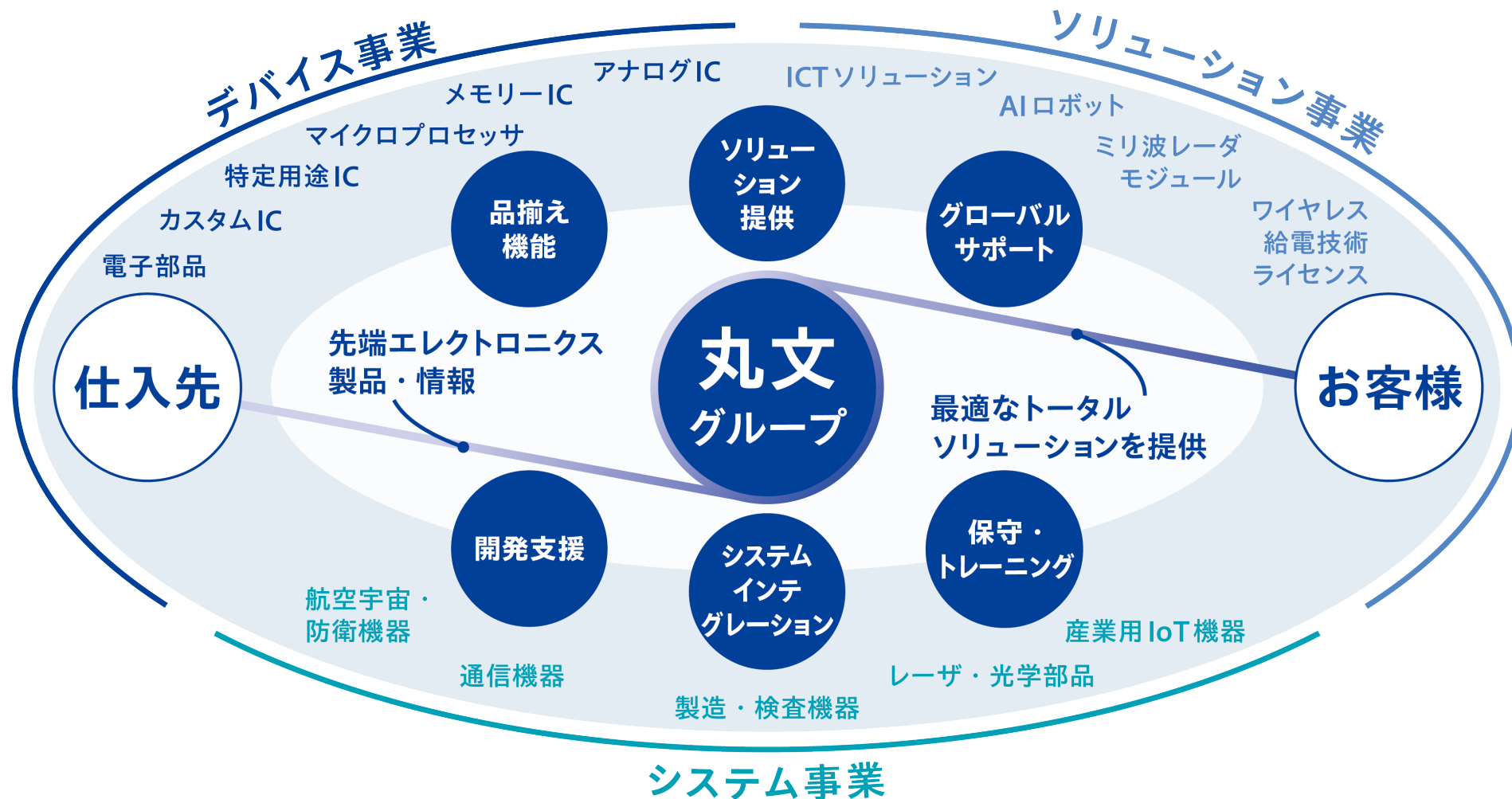
# グローバルネットワーク





# 事業内容

- ▶ 丸文の「6つの機能」が仕入れから運用までフルサポート
- ▶ エレクトロニクス商社として、「お客様のメリットに直結するソリューション」を最適な形で提供



# デバイス事業：主要取扱い製品

品目 Item  主要仕入先 (アルファベット順) Suppliers	半導体					電子部品		
	アナログIC	メモリーIC	マイクロプロセッサ	特定用途IC	カスタムIC	電子部品	電子機器	その他
	標準アナログ、センサー、 ディスプレイ	フラッシュ、 DRAM	MPU、MCU、 DSP	ASSP、LED	カスタム、 ASIC、FPGA	ディスプレイ、水晶振動子、 コネクタ・スイッチ・基板	IoT機器、 医療機器	パワーサプライ、ボードPC、 ソフトウェア、IPライセンス
エイブリック	●	●						
Allegro MicroSystems	●			●				
Analog Devices	●		●	●		●	●	
旭化成エレクトロニクス	●		●	●	●			
ATP		●						
Broadcom	●			●	●		●	●
Etron		●						
ELAN			●	●				
eYs3D				●			●	
Genesys Logic				●				
GOWIN					●			
Infineon Technologies	●	●	●	●				
ISSI	●	●		●				
Microchip	●	●	●	●	●	●		
Molex						●		
MPS※	●							
PixArt				●				
Nuvoton	●		●	●	●			
Qorvo	●		●	●	●			
REFOND				●				
SEMTECH	●			●				
セイコーエプソン			●	●	●	●	●	
Semikron Danfoss	●							
Synaptics			●	●				
TE Connectivity	●					●		
Telit						●		
VISHAY	●			●				●
Western Digital		●						
Wolfspeed	●							

※：Monolithic Power Systems, Inc.



# システム事業：主要取扱い製品

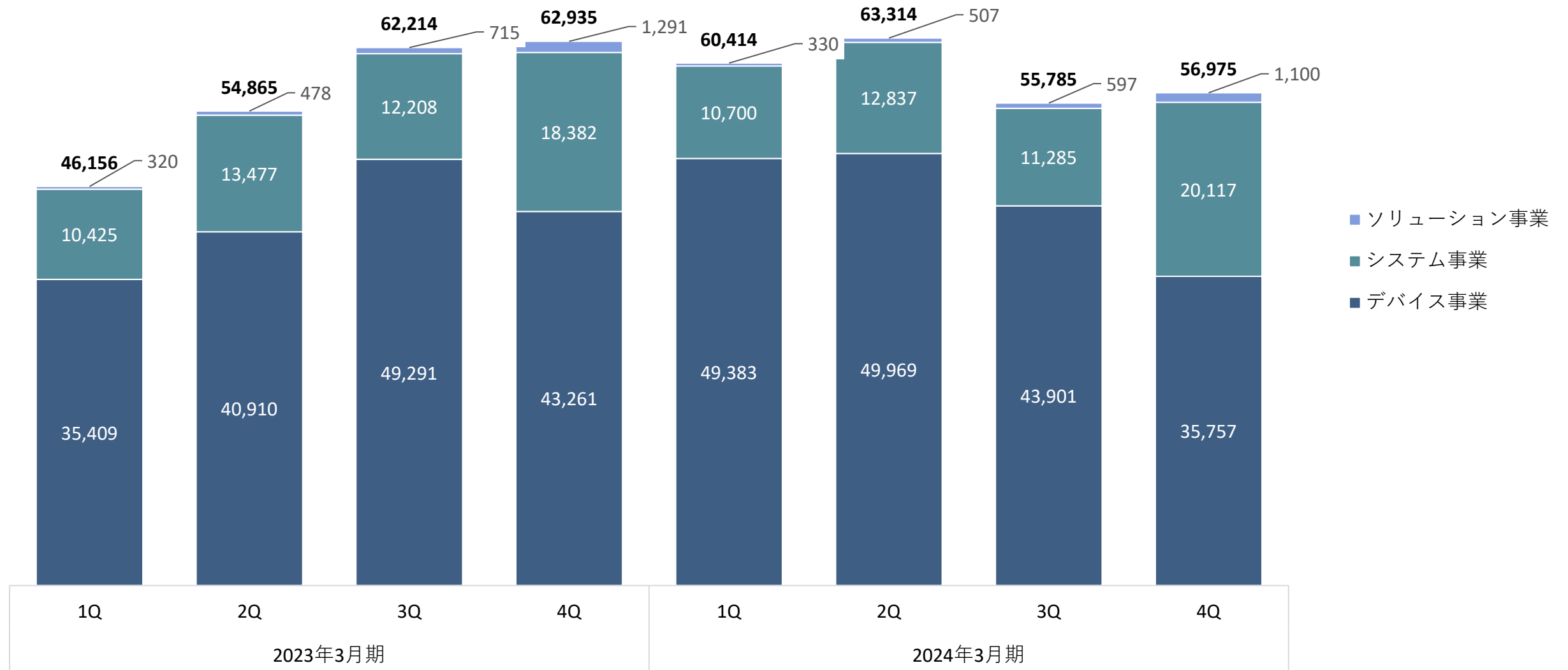
分野	主要商品	主要仕入先
<b>航空宇宙機器</b>		
航空関連機器	電磁波情報収集機材、レーダーシステム、ポアサイト整備機材、 テレメトリ受信・変復調装置、データ収録装置、アンテナ、耐環境ディスプレイ フライト/ドライビングシミュレータ、係留型飛行船	SAAB AB、Textron Systems、L3Harris Technologies Telemetry & RF Products、Communication & Power Industries Systems Engineering & Management Company、ScioTeq bvba、TREALITY SVS Belgium BV、Ansible Motion、Raven Aerostar
宇宙関連機器	宇宙用高信頼性部品及びコンポーネント、光学エンコーダ、各種ボード機器	Comtech Mission-Critical Technologies、Sensitron Semiconductor、 Syrlinks、BEI Precision Systems & Space、Aitech Defense Systems、STMicroelectronics
高周波電子機器	クライストロン、進行波管、増幅器、アンテナシステム、 導波管及び同軸コンポーネント、電力計、周波数コンバータ	Communication & Power Industries、Bird Electronic、 Work Microwave GmbH
計測機器、各種センサー	各種センサ（加速度、圧力、荷重、マイクロフォン、角速度、変位）、近傍スイッチ データ収録解析装置、衝突試験用ハニカムバリア、部分放電監視機、多機能測定器	ENDEVCO、日本ベーカーヒューズ (Baker Hughes)、日本ハネウエル ジャパン (Honeywell Japan)、DTS、G.R.A.S. Sound & Vibration A/S、mg-sensor、電子応用 (Applied Electronics)、PLASCORE、IRIS Power、Liquid Instruments
<b>産業機器</b>		
検査装置	3次元X線検査装置、ロックイン発熱解析装置、Wafer検査装置、 自動検査システム、光学式燃焼解析センサー、高分解能分光器	ユー・エイチ・システム (U.H.SYSTEM)、日本エフイー・アイ (FEI Company Japan)、日本ベーカーヒューズ (Baker Hughes) ハイメック (HIMEC)、LaVision
製造装置・組立装置	電子部品組立装置、温度特性検査装置、精密接合装置、 大気圧プラズマ表面改質装置	アキム (Akim)、山岡製作所 (YAMAOKA SEISAKUSHO)、日本アビオニクス (Nippon Avionics)、FUJI、HELLER Industries、SET
組込みソリューション	BUS型CPUボード、各種PCボード	ADLINK TECHNOLOGY、ASUS IoT、AAEON、AVALDATA、ASRock、DFI、TechNexion、SMART Embedded Computing、Aitech Systems
<b>レーザー機器</b>		
レーザー発振器・レーザー加工機	高出力半導体レーザー、産業用ファイバーレーザー、産業用フェムト秒レーザー レーザー加工装置	nLIGHT、Laserline、Amplitude、NUTECH、FUTONICS、Scansonic OPTICAL ENGINES
光源、光学部品・モジュール	LED、半導体レーザー、フラッシュランプ、キセノンランプ、各種センサ、光学モジュール 光源装置	Excelitas Technologies、Luminus Devices、TE Connectivity(First Sensor)、 Young Optics、ViALUX、Visitech Engineering、United Power Research Technology
<b>医用機器</b>		
画像診断機器	MRI、CT、DR/X-ray、超音波診断装置	島津製作所 (Shimadzu)、シーメンスヘルスケア (Siemens Healthcare)、コニカミノルタジャパン (Konica Minolta Japan) 富士フイルムヘルスケア (FUJIFILM Healthcare)
人工透析機器	人工透析装置、ダイヤライザー、血液浄化システム	日機装 (Nikkiso)、旭化成メディカル (Asahi Kasei Medical)、カネカメディックス (Kaneka Medix)
臨床検査機器	臨床検査機器	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス (Siemens Healthcare Diagnostics)、ベックマンコールター (Beckmancouiter)

# ソリューション事業：主要取扱い製品

分野	主要商品	主要仕入先
ICT ソリューション ICT Solutions		
ICT ソリューション	RF・IP通信、衛星測位、ネットワーク同期、セキュリティ、IoT	Microchip Technology、Spirent Communications、HUBER+SUHNER Polatis、Coherent、Calnex Solutions、PCTEL、Accedian、Ranplan Wireless、Bristol Instruments、Septentrio、Pendulum、EXFO
AI・ロボティクス AI・Robotics		
AI・ロボティクス	ヒューマノイドAIロボット、AIコミュニケーションロボット	Aeolus Robotics、NUWA Robotics
先端ソリューション	ミリ波レーダモジュール、カーボンナノチューブ、ワイヤレス給電技術ライセンス、フレキシブル基板、光通信IC/モジュール	エスタカヤ電子工業 (Stakaya)、Acconeer、Nanoramic、OSSIA、エレファ ンテック (Elephantech)、Silicon Line
医療機器	電子聴診器、単回使用パルスオキシメータプローブ	StethoMe、Honeywell Healthcare Solutions

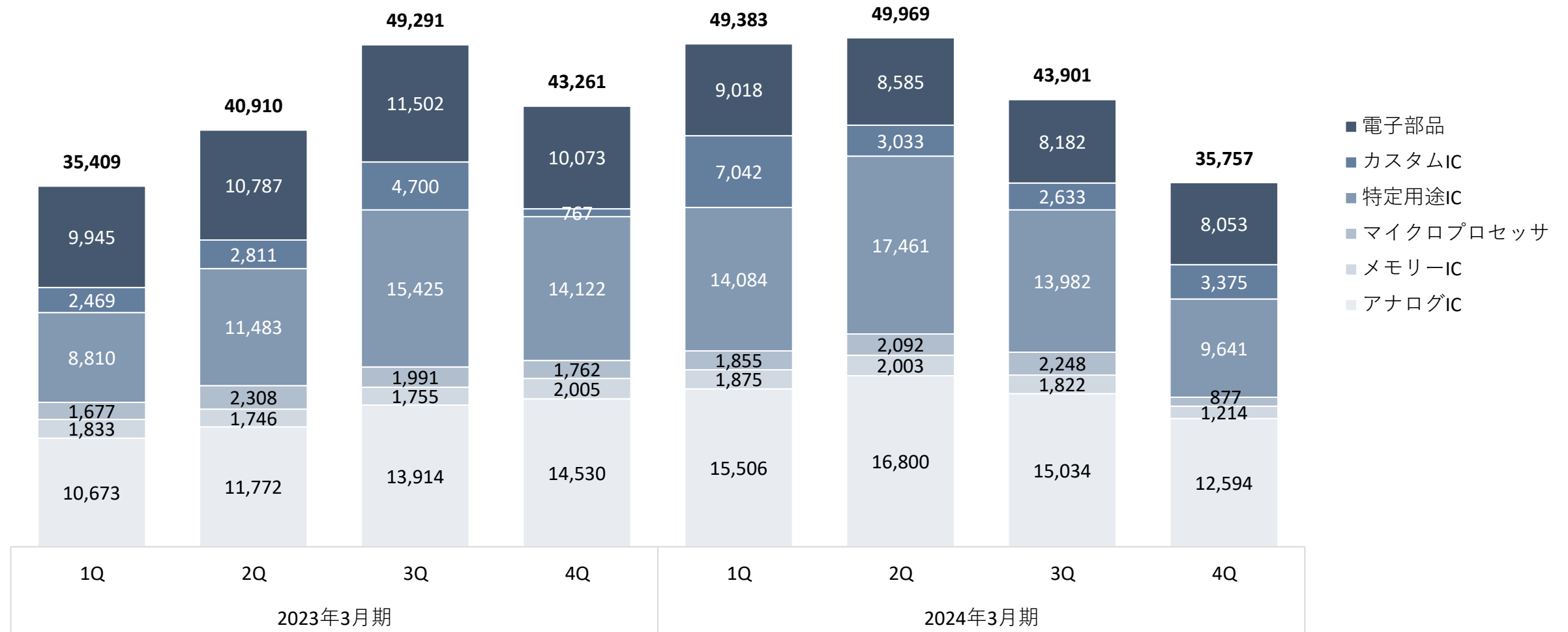
# 業績四半期推移（事業別売上高）

(百万円)



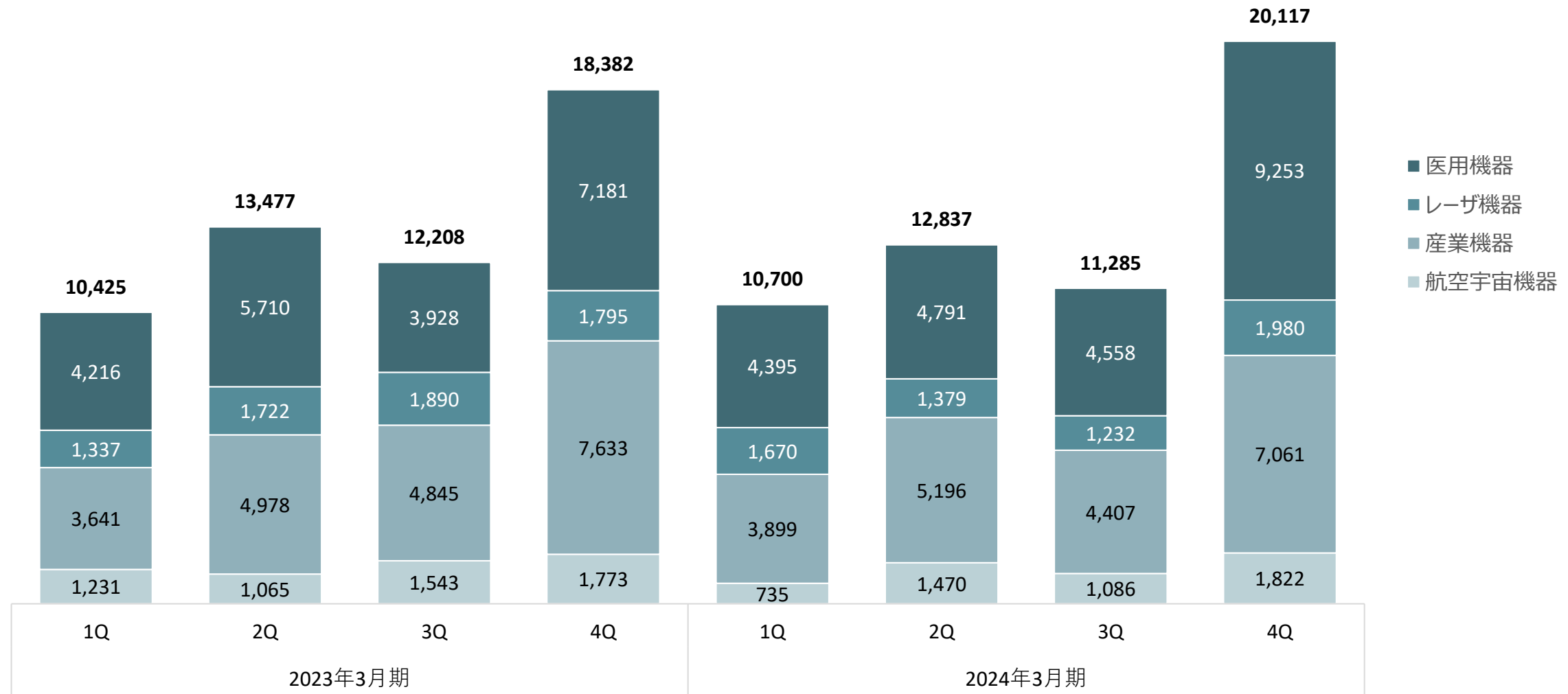
# 業績四半期推移（デバイス事業：品目別売上高）

（百万円）



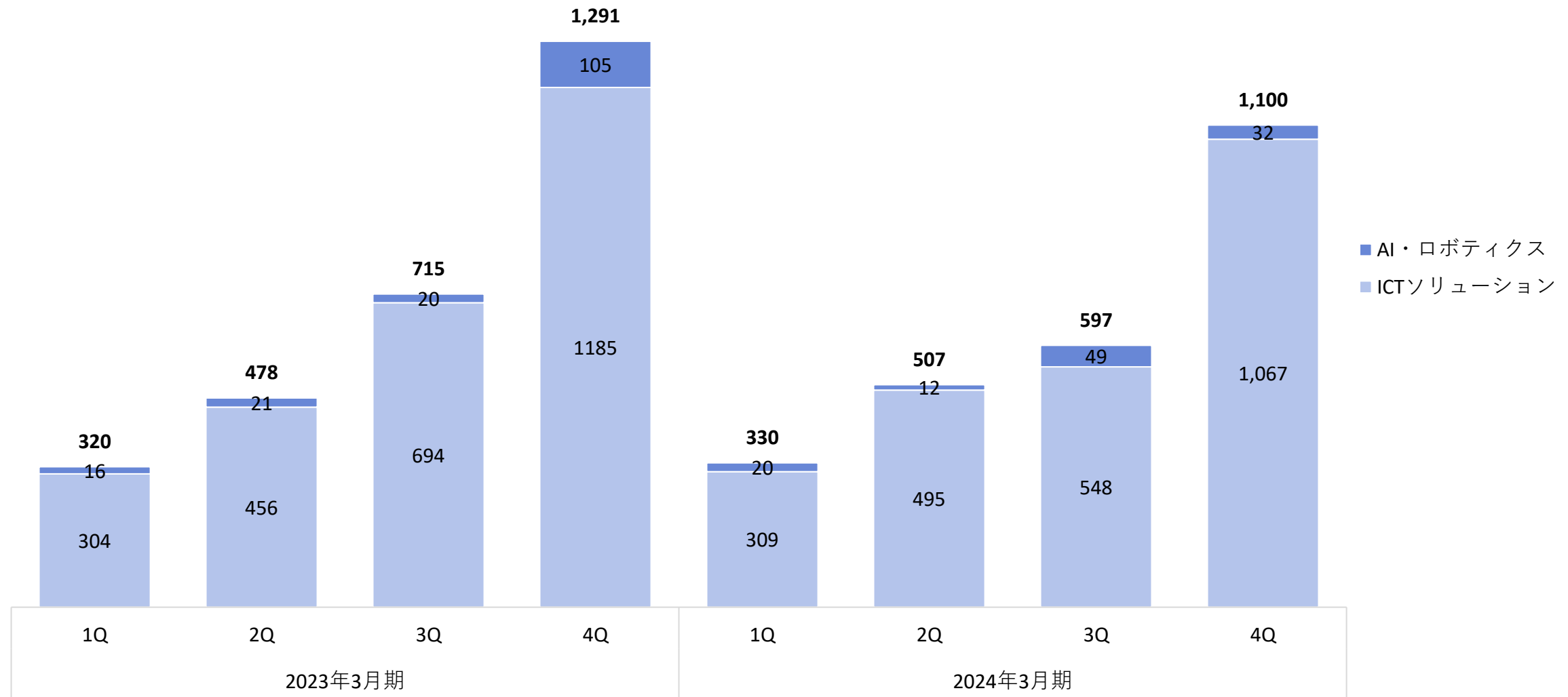
# 業績四半期推移（システム事業：品目別売上高）

（百万円）



# 業績四半期推移（ソリューション事業：品目別売上高）

（百万円）



## 本資料お取扱い上のご注意

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な重要な要素により異なる可能性がありますことをご承知おきください。

本資料に関するお問い合わせ

丸文株式会社 経営企画部

E-mail : [ir@marubun.co.jp](mailto:ir@marubun.co.jp)